

第三届土木工程新材料及新型结构学术会议通知

尊敬的专家、学者：

您好！近年来，随着我国工程建设的快速发展，涌现出众多的新型结构体系。同时，纤维增强复合材料、高性能水泥基材料、超高强钢材、再生混凝土、新型木材等新型材料以及3D打印等新兴技术的出现及应用，一方面解决了传统结构形式和传统结构材料所面临的一些难题，另一方面又为新材料及新型结构领域的发展注入了强大的生命力。基于该领域具有共性问题 and 学科交叉的特点，2014年12月，由清华大学、香港理工大学等单位发起，在清华大学举办了第一届学术研讨会；并于2016年5月、2017年11月分别在深圳（香港理工大学可持续城市发展研究院承办）、厦门（华侨大学土木工程学院承办）举办了第二届、第三届学术研讨会。

历经三届学术研讨会之后，为了进一步推动土木工程新材料与新型结构的学术研究与技术看创新，促进工程师与建筑师之间的交流与合作，增强工程界、材料企业与学术界之间的联系并建立合作渠道，加快新材料与新型结构的工程应用，在相关发起单位和参与学者提议下，分别于2018年9月21-23日和2020年9月25-27日举办了第一届（西安建筑科技大学承办）和第二届（华南理工大学承办）全国性学术会议。经中国建筑学会审核批准，“第三届土木工程新材料及新型结构学术会议”将于2023年12月1-3日在武汉举办，由华中科技大学土木与水利工程学院和国家数字建造技术创新中心承办。

我们诚挚邀请您参加本次会议，就这一学科领域的发展进行交流与研讨。

重要日期：摘要投稿截止

2023年11月15日

分会场报告安排通知

2023年11月25日

会议报到

2023年12月1日

会议日期

2023年12月1-3日

会议费用：2023年11月20日前，正式代表注册费2000元/人，学生代表注册费1000元/人；2023年11月20日后，正式代表注册费2200元/人，学生代表注册费1100元/人。包含会议相关资料、会议期间的午餐、晚餐、茶歇等费用。交通及住宿费用自理。

会议地点：武汉光谷希尔顿酒店（会议注册和会场所在酒店）。酒店价格（会议协议价）如下：大床房500元/间/天（含一份早餐）；双床房550元/间/天（含一份早餐）；双床房600元/间/天（含两份早餐）

会议专用邮箱：esms2023@163.com

组委会联系人：聂雪飞（15521204056）：会务、参展、分会场报告等

陈旭（17702776229）：会议注册、发票

陈娥（15727026641）：摘要投稿、酒店住宿

第三届土木工程新材料及新型结构学术会议组委会

华中科技大学土木与水利工程学院（代章）

国家数字建造技术创新中心

2023年11月7日